

株主の皆さまへ

第 37 期 報 告 書

2014年4月1日から2015年3月31日まで





■ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
ここに、当社第37期報告書（2014年4月1日から2015年3月31日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、消費増税にともなう駆け込み需要の反動減や長引く消費マインドの弱さにより一時マイナス成長となる等、先行き不透明感があったものの、政府の各種経済政策による雇用情勢の改善や日銀の追加金融緩和により円安メリットを享受できる企業を中心に好業績の発表が続く等、緩やかな景気回復基調となりました。

半導体業界におきましては、世界最大のスマートフォン市場となった中国において通信規格の高速データ化が進み、同市場における携帯端末向けの半導体需要が増加したほか、新型モデルのスマートフォンの堅調な販売により、半導体メーカーやOSAT各社の設備投資は順調に推移いたしました。

半導体の需要につきましては、スマートフォン向けが好調に推移したことに加え、膨大な情報を処理するためのサーバー用の需要が拡大しております。また、自動車の安全運転を補助するための車載関連の半導体についても、ますますの需要の拡大が期待されております。

このような状況のもと当社グループでは、期初計画を上回る受注高および売上高を確保することができました。

当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営施策の一つであると考えており、競争力のある製品開発を目指す研究開発投資や生産性向上を目的とする設備投資、新たな市場への事業展開に係る投資、また、財務体質の改善等に必要の内部留保を確保した上で、各事業年度の業績に応じた利益配分を実施することを基本方針としております。

この方針に基づき、当期につきましては、1株当たり10円の配当とさせていただきます。

今後とも、株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、グループ一丸となって邁進していく所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2015年6月

代表取締役社長 **岡田博和**

当社の独自技術を用いたコンプレッション方式によるモールディング装置は、従来方式では対応できない大型の基板や微細化・高密度化する半導体パッケージの増加により受注を伸ばすことができました。当社製品の市場優位性は確実に浸透しており、コンプレッション方式の装置売上比率が上昇した結果、収益面でも期初計画を上回る成果を残すことができました。評価や試作を通じてファブレス企業等にアプローチすることにより、OSAT各社からの装置受注に繋がることに成功しております。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は212億4百万円（前連結会計年度比40億38百万円、23.5%増）、営業利益16億71百万円（前連結会計年度比12億13百万円増、3.7倍）、経常利益23億16百万円（前連結会計年度比16億49百万円増、3.5倍）、当期純利益20億95百万円（前連結会計年度比15億27百万円増、3.7倍）となりました。

今後も当社グループは、コンプレッション技術を武器に、半導体のモールディング装置の売上伸張を図るとともに、電子部品のモジュール化等の新たな分野への展開を進めてまいります。

未来への挑戦—中期経営計画・TOWA10年ビジョン

昨年、当社は既存事業の伸張とコア技術の応用展開、そして「新たな市場」創造によるポートフォリオ変革等を目指す長期経営ビジョン「TOWA10年ビジョン」を掲げ、その具現化へのマイルストーンとなる諸施策・戦略等を中期（3ヵ年）経営計画として取りまとめました。

当期より始まった中期経営計画（2014年度～）につきましては、TOWA変革のプロローグ 第1章として「EQUIPMENTからPRODUCT」のキーコンセプトに沿って進めてまいりました。

最先端のパッケージ動向とお客さまのニーズを捉え、モールディング事業の伸張を目指すとともに、コンプレッション技術を用いたLED製造装置や電子部品、車載品といった他分野への展開も図ってまいります。

中期経営計画進捗状況

項目	期別	(単位:億円)		
		2015年3月期 (計画)	2015年3月期 (実績)	2016年3月期 (計画)
売上高		180	212	225
半導体製造装置事業		155	184	192
L E D 事業		11	14	15
ファインプラスチック成形品事業		12	12	13
「新たな市場」事業		2	1	5
営業利益		10	16	23
経常利益		9	23	23
当期純利益		8	20	19

## 業務改革 ものづくり企業の真価に挑む

「TOWA10年ビジョン」の実現と、中期経営計画に掲げる「市場を創造する」ものづくりの実践への取り組みの一つとして、さらなる経営基盤の強化を目指し、プロジェクトを発足いたしました。

営業活動網・活動形態の再構築と高効率生産体制の追求等の業務効率化を図ることにより、10年後を見据えた各事業における成長戦略を進めてまいります。

また、金型や装置を製作しお客さまに納めるだけでなく、部品プロダクトなど受託加工を含めた生産にどのように貢献できるか、海外も含めたTOWAグループ全体としての拠点機構改革、グローバルリーダーの育成等、TOWA事業の構造転換に向けた取り組みを一層強化しております。

### 《グローバルリーダーの育成》

- ・高度人材育成による開発力強化
- ・「個」の能力向上によるグループガバナンス強化

### 基盤強化

### 《高効率生産体制の追求》

- ・適地生産体制、各事業会社の活用
- ・開発と生産の連携

### 《営業活動網・形態の再構築》

- ・本社、グループ拠点の機構見直し
- ・営業活動における収益力の改善

## 新たなる市場へ 「市場を創造する」ものづくりの実践

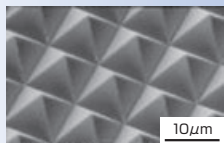
当社のコア技術を応用展開し、設備投資だけでなく新規事業にも積極的に投資してまいります。

### コンプレッション技術

半導体モールドで圧倒的な“価値の優位性”を進める

### 微細加工技術

Φ220mmの面積に高さ3.8μmのピラミッド形状を0.3μmの精度で約5万個配列できる金型加工技術  
※1μm(マイクロメートル)=0.001mm



コア技術

### プリント基板製造装置

スマートフォン向け等プリント基板の樹脂封止で採用が増加

### 自動車関連市場の拡大

- ・コンプレッション技術による車載品、AVチューナー、電子部品の樹脂モールド

- ・凸レンズに超微細加工したヘッドアップディスプレイ用マイクロレンズアレイの製品化

応用展開



### 工具販売

高精度、長寿命、低価格のCBNエンドミルを提供



高離型コーティング技術バンセラ

ガラスカット事業

ほか

新事業領域

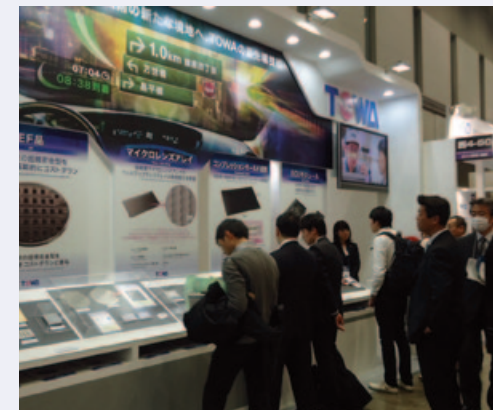
## TOPICS トピックス

### ネプコンジャパン 出展

2015年1月14日から16日の3日間にわたり、東京ビッグサイトで開催されましたアジア最大級のエレクトロニクス技術展「ネプコンジャパン2015」に出展いたしました。

既存の半導体製品に加え、TOWAのコア技術である微細加工技術をベースとした新技術をご提案し、次世代を担う製品の数々をご紹介いたしました。

当社ブースへは、前回出展時を大きく上回るお客さまにご来場いただき、これまでに培ってきたコア技術を元に、新たな市場への事業展開を図る今、TOWAの技術をより多くのお客さまに、お伝えすることができました。



### セミコンチャイナ 出展

2015年3月17日から19日に中国・上海で開催されました「セミコンチャイナ2015」に出展いたしました。

中国IC産業ファンド発足を起爆剤に、これから中国の半導体産業が発展の第2ステージに移るとされ、市場の拡大が予想されています。

今回のセミコンチャイナは、これまで以上に半導体の展示が活況を呈しており、当社ブースにも多くのお客さまにご来場いただき、大変盛況でした。

また、活発な情報交換が行なわれ、今後の拡販に繋がる貴重な機会となりました。

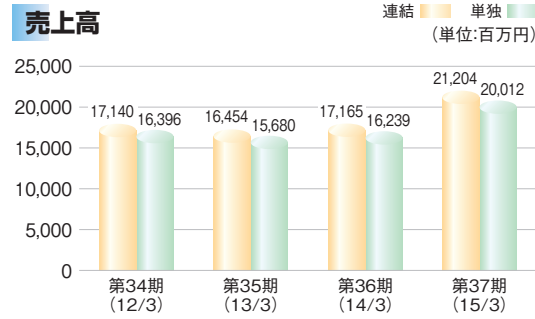


### 個人投資家向け会社説明会を開催

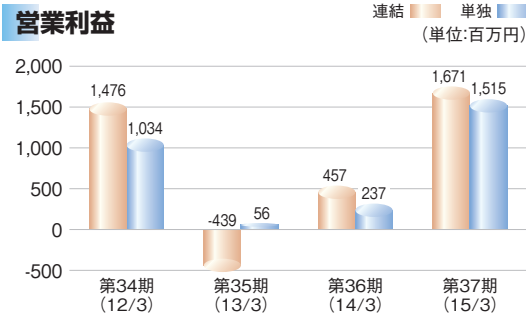
2015年1月、SMBC日興証券主催の個人投資家向け会社説明会を開催いたしました。当社の事業内容や企業文化を感じていただけるよう、こうした説明会やセミナーをはじめ、今後も様々な活動を展開してまいります。

# 業績の推移

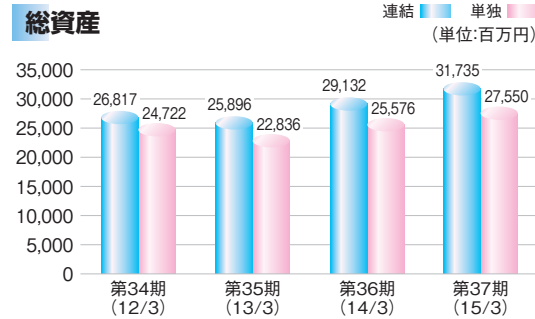
## 売上高



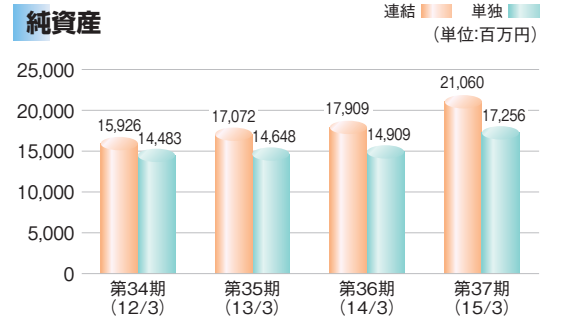
## 営業利益



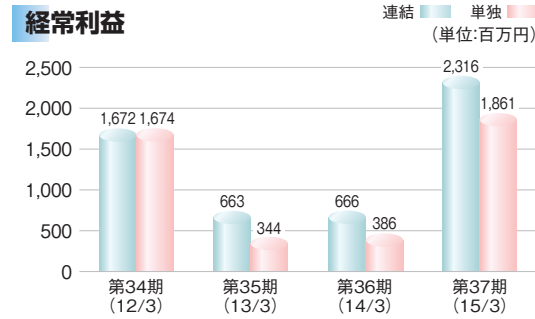
## 総資産



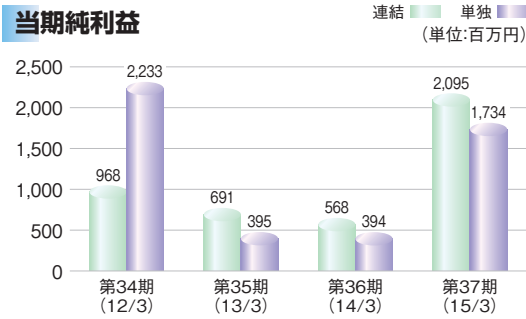
## 純資産



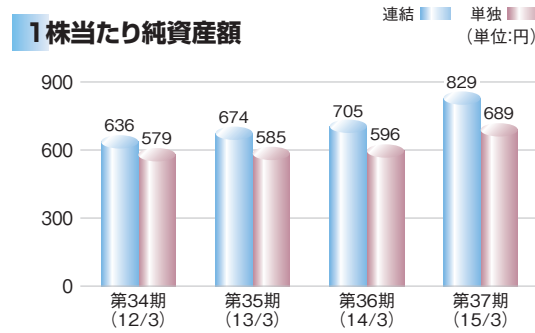
## 経常利益



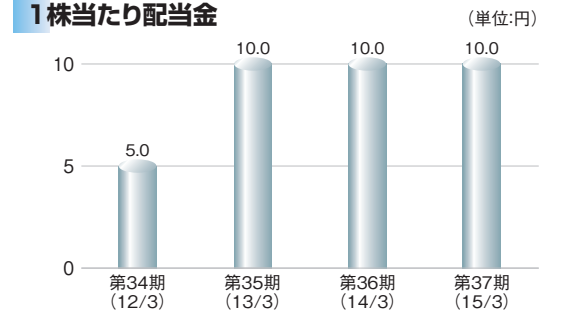
## 当期純利益



## 1株当たり純資産額

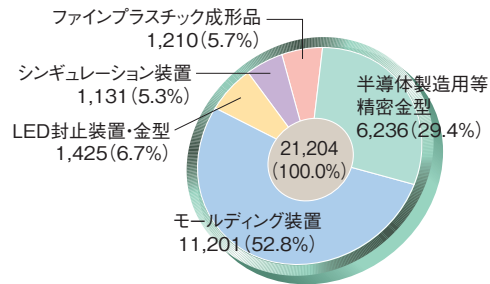


## 1株当たり配当金

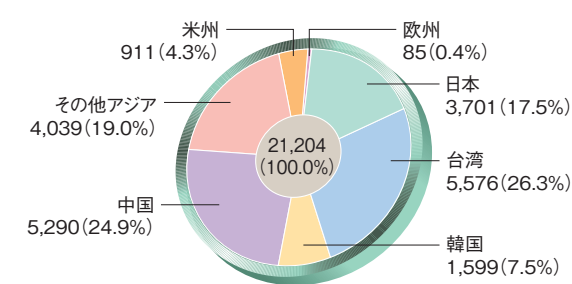


## [セグメント別連結売上高 (第37期)]

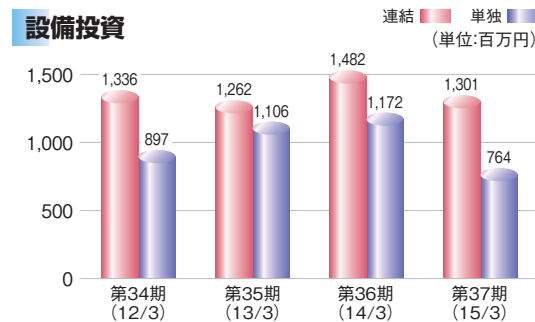
### 製品別 (単位:百万円)



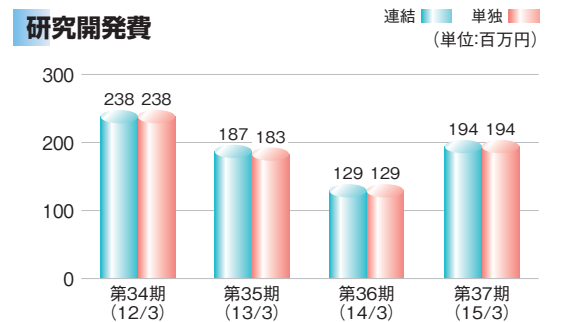
### 地域別 (単位:百万円)



## 設備投資



## 研究開発費



## 決算概要

連結貸借対照表 (2015年3月31日現在)

(単位: 百万円)

科目	金額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	17,408
現金および預金	6,127
受取手形および売掛金	7,165
電子記録債権	93
たな卸資産	3,453
その他	570
固定資産	14,326
有形固定資産	10,788
建物および構築物	3,917
土地	4,203
その他	2,668
無形固定資産	627
投資その他の資産	2,910
資産合計	31,735

(注) 当期の連結子会社は13社、持分法適用会社は1社であります。

連結損益計算書

(2014年4月1日から2015年3月31日まで)

(単位: 百万円)

科目	金額
売上高	21,204
売上原価	14,972
売上総利益	6,231
販売費および一般管理費	4,560
営業利益	1,671
営業外収益	737
営業外費用	92
経常利益	2,316
特別利益	364
特別損失	412
税金等調整前当期純利益	2,268
法人税・住民税および事業税	137
法人税等調整額	6
少数株主損益調整前当期純利益	2,124
少数株主利益	28
当期純利益	2,095

科目	金額
<b>【負債および純資産の部】</b>	
流動負債	7,130
支払手形および買掛金	2,572
短期借入金	834
一年以内返済予定長期借入金	1,490
その他	2,234
固定負債	3,544
長期借入金	2,705
その他	839
負債合計	10,674
株主資本	18,794
資本金	8,932
資本剰余金	462
利益剰余金	9,409
自己株式	△ 9
その他の包括利益累計額	1,946
その他有価証券評価差額金	1,023
為替換算調整勘定	789
退職給付に係る調整累計額	133
少数株主持分	318
純資産合計	21,060
負債・純資産合計	31,735

連結キャッシュ・フロー計算書

(2014年4月1日から2015年3月31日まで)

(単位: 百万円)

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,612
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,452
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,173
現金および現金同等物に係る換算差額	96
現金および現金同等物の増減額	83
現金および現金同等物の期首残高	5,533
現金および現金同等物の期末残高	5,617

連結株主資本等変動計算書 (2014年4月1日から2015年3月31日まで)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2014年4月1日 期首残高	8,932	462	7,208	△ 8	16,594
会計方針の変更による累積的影響額			355		355
会計方針の変更を反映した2014年4月1日 期首残高	8,932	462	7,563	△ 8	16,949
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△ 250		△ 250
当期純利益			2,095		2,095
自己株式の取得				△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	1,845	△ 0	1,845
2015年3月31日 期末残高	8,932	462	9,409	△ 9	18,794

	その他の包括利益累計額				少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
2014年4月1日 期首残高	509	511	35	1,057	257	17,909
会計方針の変更による累積的影響額						355
会計方針の変更を反映した2014年4月1日 期首残高	509	511	35	1,057	257	18,264
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△ 250
当期純利益						2,095
自己株式の取得						△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	513	277	97	889	61	950
連結会計年度中の変動額合計	513	277	97	889	61	2,795
2015年3月31日 期末残高	1,023	789	133	1,946	318	21,060

## 会社の概要

商号	TOWA株式会社 (英文名TOWA CORPORATION)		
設立	1979年4月17日		
資本金	8,932,627,777円		
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎(075) 692-0250(代表)		
従業員数	445名		
役員 (2015年6月26日現在)	代表取締役社長	岡田博和	
	専務取締役	天川剛	
	常務取締役	小西久二	
	取締役執行役員	浦上浩住	
	取締役執行役員	田村吉住	
	取締役	桑木肇一	
	執行役員	石田耕利	
	執行役員	岸本昌重	
	執行役員	蒲生喜代	
	常勤監査役	小林久芳	
	監査役	杉山公大	
	監査役	和氣大輔	
ホームページ	<a href="http://www.towajapan.co.jp">http://www.towajapan.co.jp</a>		
上場取引所	東京証券取引所市場第一部		

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
定時株主総会	毎年6月
基準日	株主総会権利行使および期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
郵便物の郵送先及び 電話お問合せ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-288-324(フリーダイヤル)
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行 本店および全国各支店 みずほ銀行 本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります)
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、 やむをえない事由により電子公告を することができない場合は、日本経済新 聞に掲載します。 公告掲載URL <a href="http://www.towajapan.co.jp">http://www.towajapan.co.jp</a>

## 株式の状況 (2015年3月31日現在)

●発行可能株式総数	80,000,000株
●発行済株式の総数	25,021,832株
●株主数	8,162名
●大株主	

株主名	持株数	持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 有限会社ケイビー恒産 坂東和彦	2,537 2,000 1,555	10.14 8.00 6.22
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,062	4.25
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS	880	3.52
株式会社京都銀行	699	2.80
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	564	2.26
資産管理サービス信託銀行株式会社	530	2.12
CBLDN KIA FUND 136	515	2.06
JP MORGAN CHASE BANK 385181	509	2.04

- (注1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るものです。
- (注2) 持株比率は、自己株式(11,059株)を控除して計算しております。
- (注3) 坂東和彦氏は2014年6月22日に逝去されましたが、2015年3月31日現在、株主義書換手続き未了のため、株主名簿上の名義で記載しております。

## TOWAグループ (2015年3月31日現在)

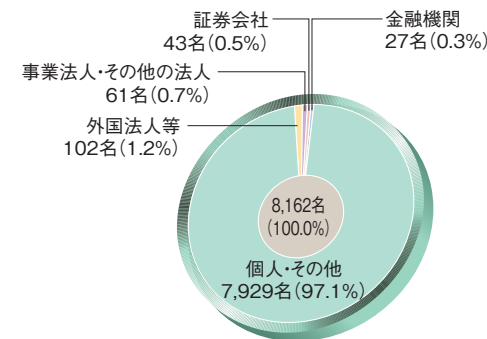
### ■国内

TOWA株式会社  
本社・工場  
京都東事業所  
坂東記念研究所  
九州事業所  
東京営業所  
株式会社バンディック  
TOWATEC株式会社  
株式会社サーク

### ■海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)  
TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)  
TOWA Semiconductor Equipment  
Philippines Corp. (フィリピン)  
TOWA USA Corporation (米国)  
TOWA Europe B.V. (オランダ)  
東和半導体設備(上海)有限公司(中国)  
上海沙迪克軟件有限公司(中国)  
TOWA半導体設備(蘇州)有限公司(中国)  
蘇州STK鑄造有限公司(中国)  
台湾東和半導体設備股份有限公司(台湾)  
巨東精技股份有限公司(台湾)  
TOWA韓国株式会社(韓国)  
株式会社東進(韓国)

### ■所有者別株主数分布



### ■所有者別株式数分布

